

平成29年 2月 6日

NEDIA 会員各位

日本電子デバイス産業協会
材料部品部会 小林 関司

「第十四回勉強会」の開催について

立春の候 皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。

早速ですが、下記の日程で材料部品部会(旧 JAST 部会)主催の「第十四回勉強会」を開催いたします。

2017 年の年明けは、トランプ次期アメリカ大統領の就任、イギリスのEU離脱、中国情勢等による世界的な不安定要素が日本経済に及ぼす影響も大いに懸念されます。このような混沌とした状況の中で我々としては、今後どのような戦略的、技術的対応をすればよいのかを勉強したいと思います。

今回の勉強会は、従来使用してきました御茶ノ水めっきセンターではなく早稲田大学の会議室を使わせていただきますのでご注意願います。大勢の方のご参加をお待ちしております。

— 記 —

日時 平成29年3月15日(水曜日) 13:00-16:00

場所 早稲田大学 55号館 N棟 第二会議室 (最寄り駅 地下鉄副都心線 西早稲田駅 直結)

東京都新宿区大久保 3-4-1

[スケジュール]

(1) 13:00~13:45 (45分)

講師 宇都宮 久修氏/インターコネクション・テクノロジーズ(株) 代表取締役

テーマ 「Heterogeneous Integration 動向」

~~従来の SIP の概念を拡大し、複合技術を用いた半導体パッケージ技術~~

(2) 13:45~14:30 (45分)

講師 稲垣 義勝氏/古河電気工業(株)サーマル・電子部品事業部門 開発部コンテンツ開発課長

テーマ 「サーマル製品の技術紹介」

休憩 14:30~14:45 (15分)

(3) 14:45~16:00 (75分)

講師 所 千晴氏/早稲田大学 理工学術院 教授

テーマ 「都市鉱山利用に寄与する固体分離技術」

(注 1) 今回参加される方には、資料代として 2,000 円/人徴収いたします。(非会員の方には、資料代込みで 5,000 円)

(注 2) 添付いたします出欠用紙での回答を、3月 8日までにメールでお願いいたします。なお資料等の準備の関係で定員(60名)になり次第参加申し込みを締め切らせていただきます。

以上